

2025-2030年中国半导体光刻胶行业发展前景预测与投资战略规划分析报告

目 录

CONTENTS

——综述篇——

第1章：半导体光刻胶行业综述及数据来源说明

1.1 光刻胶行业界定

- 1.1.1 光刻胶的定义
- 1.1.2 光刻是半导体制造微图形工艺的核心，光刻胶是关键材料
- 1.1.3 光刻胶技术参数
- 1.1.4 光刻胶所处行业
- 1.1.5 按下游应用分类
 - 1、半导体光刻胶
 - 2、显示光刻胶
 - 3、PCB光刻胶
 - 4、其他

1.2 半导体光刻胶行业分类

1.3 本报告研究范围界定说明

1.4 光刻胶行业市场监管&标准体系

- 1.4.1 光刻胶行业监管体系及机构职能
- 1.4.2 光刻胶行业标准体系及建设进程
 - 1、光刻胶行业现行国家标准建设现状
 - 2、光刻胶行业现行企业标准建设现状
 - (1) 光刻胶行业现行企业标准汇总
 - (2) 光刻胶行业现行企业标准分析

1.5 本报告数据来源及统计标准说明

- 1.5.1 本报告权威数据来源
- 1.5.2 本报告研究方法及统计标准说明

——现状篇——

第2章：全球半导体光刻胶行业发展现状及趋势洞察

2.1 全球光刻胶行业发展历程

- 2.1.1 萌芽期
- 2.1.2 初步发展期
- 2.1.3 快速发展期

2.2 全球光刻胶技术进展及产品研发进度

- 2.2.1 全球半导体光刻胶技术进展情况
- 2.2.2 全球半导体光刻胶厂商产品研发进度

2.3 全球半导体光刻胶行业发展现状分析

- 2.3.1 全球半导体光刻胶工厂分布
- 2.3.2 全球半导体光刻胶量产进度
- 2.3.3 全球半导体光刻胶细分市场
- 2.3.4 全球半导体产业发展现状及光刻胶需求分析

2.4 全球半导体光刻胶行业市场竞争状态及格局分析

- 2.4.1 全球光刻胶行业兼并重组状况
- 2.4.2 全球半导体光刻胶行业市场竞争格局
- 2.4.3 全球半导体光刻胶行业市场集中度
- 2.4.4 全球半导体光刻胶行业区域发展格局
- 2.4.5 全球半导体光刻胶重点区域市场分析
 - 1、美国
 - 2、日本

2.5 全球半导体光刻胶行业市场规模体量及前景预判

- 2.5.1 全球半导体光刻胶行业市场规模体量
- 2.5.2 全球半导体光刻胶行业市场前景预测（未来5年预测）

- 2.5.3 全球半导体光刻胶行业发展趋势洞悉
- 2.6 全球半导体光刻胶行业发展经验总结和有益借鉴
- 第3章：中国半导体光刻胶行业发展现状及市场痛点
 - 3.1 中国半导体光刻胶行业发展历程
 - 3.2 中国半导体光刻胶行业技术进展
 - 3.2.1 半导体光刻胶行业科研投入（力度及强度）
 - 3.2.2 半导体光刻胶行业科研创新（专利与转化）
 - 3.2.3 半导体光刻胶行业关键技术（现状与突破）
 - 3.2.4 半导体光刻胶制备过程
 - 3.3 中国半导体光刻胶行业对外贸易状况
 - 3.3.1 海关总署——半导体光刻胶归类
 - 3.3.2 中国光刻胶进出口贸易概况（过去5年数据）
 - 3.3.3 中国光刻胶进口贸易状况（过去5年数据）
 - 1、光刻胶行业进口贸易规模
 - 2、光刻胶行业进口价格水平
 - 3、光刻胶行业进口产品结构
 - 3.3.4 中国光刻胶出口贸易状况（过去5年数据）
 - 1、光刻胶行业出口贸易规模
 - 2、光刻胶行业出口价格水平
 - 3、光刻胶行业出口产品结构
 - 3.3.5 中国光刻胶行业进出口贸易影响因素及发展趋势
 - 3.4 中国半导体光刻胶行业市场主体
 - 3.4.1 半导体光刻胶行业市场主体类型
 - 3.4.2 半导体光刻胶行业企业入场方式
 - 3.5 中国半导体光刻胶行业市场供给分析
 - 3.5.1 半导体光刻胶企业仍然较少
 - 3.5.2 光刻胶产量（万吨）
 - 3.5.3 半导体光刻胶主要企业产能
 - 3.6 中国半导体光刻胶行业市场需求分析
 - 3.6.1 半导体光刻胶需求量（万吨）
 - 3.6.2 半导体光刻胶行业自给率
 - 3.6.3 半导体光刻胶市场行情走势
 - 3.7 中国半导体光刻胶行业市场规模体量
 - 3.7.1 中国光刻胶行业市场规模体量
 - 3.7.2 半导体光刻胶行业市场规模体量
 - 3.8 中国半导体光刻胶行业市场竞争格局
 - 3.8.1 中国半导体光刻胶行业企业竞争格局
 - 3.8.2 中国半导体光刻胶行业市场集中度
 - 3.9 中国半导体光刻胶国产替代布局现状
 - 3.9.1 中国半导体光刻胶国产替代必然性分析
 - 1、半导体光刻胶处于各行业产业链上游，具有举足轻重的地位
 - 2、半导体材料国产化的必然趋势
 - 3、光刻胶国产代替是中国半导体产业的迫切需要
 - 3.9.2 中国半导体光刻胶国产替代现状
 - 3.9.3 中国半导体光刻胶国产替代趋势
 - 3.10 中国半导体光刻胶行业市场发展痛点
- 第4章：半导体光刻胶产业链全景及配套产业发展
 - 4.1 半导体光刻胶产业链结构梳理
 - 4.2 半导体光刻胶产业链生态图谱
 - 4.3 半导体光刻胶产业链区域热力图
 - 4.4 半导体光刻胶行业成本投入结构
 - 4.4.1 光刻胶在半导体成本中的比重
 - 4.4.2 光刻胶原材料构成及主要作用
 - 4.4.3 半导体制造材料成本结构
 - 4.4.4 日本和美国主导全球光刻胶原材料市场
 - 4.5 光刻胶原材料：光刻胶单体及树脂
 - 4.5.1 光刻胶用树脂类型及特征
 - 4.5.2 光刻胶单体概述
 - 4.5.3 树脂市场供应情况

- 1、产品供应情况
- 2、产品供应商情况
- 3、产品价格情况
- 4.5.4 光刻胶用树脂发展趋势
- 4.6 光刻胶原材料：光敏材料**
- 4.6.1 光刻胶用光敏材料概述
 - 1、光引发剂
 - 2、光致产酸剂——光酸（PAG）
- 4.6.2 光引发剂市场供应情况
 - 1、产品供应情况
 - 2、产品供应商情况
 - 3、产品价格情况
- 4.6.3 光刻胶用光引发剂发展趋势
- 4.7 光刻胶原材料：溶剂**
- 4.7.1 光刻胶用溶剂概述
- 4.7.2 溶剂市场供应情况
 - 1、产能建设及产品应用情况
 - 2、产品供应情况
 - 3、产品供应商情况
 - 4、产品价格情况
- 4.7.3 光刻胶用溶剂发展趋势
- 4.8 光刻胶原材料：其他助剂**
- 4.9 配套产业布局对半导体光刻胶行业的影响总结**
- 第5章：中国半导体光刻胶行业细分产品市场分析**
- 5.1 中国半导体光刻胶行业细分市场概况**
- 5.1.1 中国半导体光刻胶行业细分市场对比
- 5.1.2 中国半导体光刻胶行业细分市场结构
- 5.2 半导体光刻胶细分市场：G线光刻胶**
- 5.2.1 G线光刻胶概述
- 5.2.2 G线光刻胶市场简析
 - 1、主要企业
 - 2、市场规模
 - 3、国产化进程
- 5.3 半导体光刻胶细分市场：I线光刻胶**
- 5.3.1 I线光刻胶概述
- 5.3.2 I线光刻胶市场简析
 - 1、主要企业
 - 2、市场规模
 - 3、国产化进程
- 5.4 半导体光刻胶细分市场：KrF光刻胶**
- 5.4.1 KrF光刻胶概述
- 5.4.2 KrF光刻胶市场简析
 - 1、主要企业
 - 2、市场规模
 - 3、国产化进程
- 5.5 半导体光刻胶细分市场：ArF光刻胶**
- 5.5.1 ArF光刻胶概述
- 5.5.2 ArF光刻胶市场简析
 - 1、主要企业
 - 2、市场规模
 - 3、国产化进程
- 5.6 半导体光刻胶细分市场：EUV光刻胶**
- 5.6.1 EUV光刻胶概述
- 5.6.2 EUV光刻胶市场简析
 - 1、主要企业
 - 2、市场规模
 - 3、国产化进程
- 5.7 中国半导体光刻胶行业细分市场影响因素及发展趋势**
- 5.7.1 半导体光刻胶细分市场影响因素

- 5.7.2 半导体光刻胶细分市场发展趋势
- 5.8 中国半导体光刻胶行业细分市场战略地位分析
- 第6章：中国半导体光刻胶行业细分应用市场分析
 - 6.1 半导体产业市场现状
 - 6.1.1 全球半导体产业向中国大陆转移
 - 6.1.2 中国半导体产业市场规模
 - 6.1.3 中国半导体产业细分市场
 - 6.1.4 中国集成电路市场规模
 - 6.1.5 中国集成电路市场结构
 - 6.2 中国半导体产业趋势前景
 - 6.2.1 中国半导体产业前景预测
 - 6.2.2 中国半导体产业发展趋势
 - 6.3 半导体光刻胶细分应用领域分布
 - 6.4 半导体光刻胶细分应用：逻辑IC
 - 6.4.1 逻辑IC领域半导体光刻胶应用概述
 - 6.4.2 逻辑IC市场现状及发展趋势
 - 1、逻辑IC市场现状
 - 2、逻辑IC发展趋势
 - 6.4.3 逻辑IC领域半导体光刻胶应用市场现状
 - 6.4.4 逻辑IC领域半导体光刻胶应用市场潜力
 - 6.5 半导体光刻胶细分应用：动态随机存取存储器（DRAM）
 - 6.5.1 动态随机存取存储器（DRAM）领域半导体光刻胶应用概述
 - 6.5.2 动态随机存取存储器（DRAM）市场现状及发展趋势
 - 1、动态随机存取存储器（DRAM）市场现状
 - 2、动态随机存取存储器（DRAM）发展趋势
 - 6.5.3 动态随机存取存储器（DRAM）领域半导体光刻胶应用市场现状
 - 6.5.4 动态随机存取存储器（DRAM）领域半导体光刻胶应用市场潜力
 - 6.6 半导体光刻胶细分应用：NVM（非易失性内存）
 - 6.6.1 NVM（非易失性内存）领域半导体光刻胶应用概述
 - 6.6.2 NVM（非易失性内存）市场现状及发展趋势
 - 1、NVM（非易失性内存）市场现状
 - 2、NVM（非易失性内存）发展趋势
 - 6.6.3 NVM（非易失性内存）领域半导体光刻胶应用市场现状
 - 6.6.4 NVM（非易失性内存）领域半导体光刻胶应用市场潜力
 - 6.7 中国半导体光刻胶行业细分应用市场战略地位分析
- 第7章：全球及中国半导体光刻胶企业布局案例解析
 - 7.1 全球及中国半导体光刻胶主要企业布局梳理
 - 7.2 全球半导体光刻胶主要企业布局案例分析（不分先后，可定制）
 - 7.2.1 日本合成橡胶（JSR）
 - 1、企业发展历程&基本信息
 - 2、企业业务架构&经营情况
 - 3、企业半导体光刻胶业务布局&发展现状
 - 4、企业半导体光刻胶业务销售&在华布局
 - 7.2.2 日本信越化学
 - 1、企业发展历程&基本信息
 - 2、企业业务架构&经营情况
 - 3、企业半导体光刻胶业务布局&发展现状
 - 4、企业半导体光刻胶业务销售&在华布局
 - 7.2.3 日本东京应化（TOK）
 - 1、企业发展历程&基本信息
 - 2、企业业务架构&经营情况
 - 3、企业半导体光刻胶业务布局&发展现状
 - 4、企业半导体光刻胶业务销售&在华布局
 - 7.2.4 美国杜邦
 - 1、企业发展历程&基本信息
 - 2、企业业务架构&经营情况
 - 3、企业半导体光刻胶业务布局&发展现状
 - 4、企业半导体光刻胶业务销售&在华布局
 - 7.2.5 日本富士胶片

- 1、企业发展历程&基本信息
 - 2、企业业务架构&经营情况
 - 3、企业半导体光刻胶业务布局&发展现状
 - 4、企业半导体光刻胶业务销售&在华布局
- 7.3 中国半导体光刻胶主要企业布局案例分析（不分先后，可定制）**
- 7.3.1 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
- 1、企业发展历程&基本信息
 - 2、企业业务架构&经营情况
 - 3、企业半导体光刻胶产品/产线布局
 - 4、企业半导体光刻胶专利技术
 - 5、企业半导体光刻胶产销情况/客户
 - 6、企业半导体光刻胶业务布局战略&优劣势
- 7.3.2 晶瑞电子材料股份有限公司
- 1、企业发展历程&基本信息
 - 2、企业业务架构&经营情况
 - 3、企业半导体光刻胶产品/产线布局
 - 4、企业半导体光刻胶专利技术
 - 5、企业半导体光刻胶产销情况/客户
 - 6、企业半导体光刻胶业务布局战略&优劣势
- 7.3.3 深圳市容大感光科技股份有限公司
- 1、企业发展历程&基本信息
 - 2、企业业务架构&经营情况
 - 3、企业半导体光刻胶产品/产线布局
 - 4、企业半导体光刻胶专利技术
 - 5、企业半导体光刻胶产销情况/客户
 - 6、企业半导体光刻胶业务布局战略&优劣势
- 7.3.4 江苏南大光电材料股份有限公司
- 1、企业发展历程&基本信息
 - 2、企业业务架构&经营情况
 - 3、企业半导体光刻胶产品/产线布局
 - 4、企业半导体光刻胶专利技术
 - 5、企业半导体光刻胶产销情况/客户
 - 6、企业半导体光刻胶业务布局战略&优劣势
- 7.3.5 上海新阳半导体材料股份有限公司
- 1、企业发展历程&基本信息
 - 2、企业业务架构&经营情况
 - 3、企业半导体光刻胶产品/产线布局
 - 4、企业半导体光刻胶专利技术
 - 5、企业半导体光刻胶产销情况/客户
 - 6、企业半导体光刻胶业务布局战略&优劣势
- 7.3.6 彤程新材料集团股份有限公司
- 1、企业发展历程&基本信息
 - 2、企业业务架构&经营情况
 - 3、企业半导体光刻胶产品/产线布局
 - 4、企业半导体光刻胶专利技术
 - 5、企业半导体光刻胶产销情况/客户
 - 6、企业半导体光刻胶业务布局战略&优劣势
- 7.3.7 厦门恒坤新材料科技股份有限公司
- 1、企业发展历程&基本信息
 - 2、企业业务架构&经营情况
 - 3、企业半导体光刻胶产品/产线布局
 - 4、企业半导体光刻胶专利技术
 - 5、企业半导体光刻胶产销情况/客户
 - 6、企业半导体光刻胶业务布局战略&优劣势
- 7.3.8 上海飞凯材料科技股份有限公司
- 1、企业发展历程&基本信息
 - 2、企业业务架构&经营情况
 - 3、企业半导体光刻胶产品/产线布局
 - 4、企业半导体光刻胶专利技术

- 5、企业半导体光刻胶产销情况/客户
- 6、企业半导体光刻胶业务布局战略&优劣势
- 7.3.9 北京欣奕华科技有限公司
 - 1、企业发展历程&基本信息
 - 2、企业业务架构&经营情况
 - 3、企业半导体光刻胶产品/产线布局
 - 4、企业半导体光刻胶专利技术
 - 5、企业半导体光刻胶产销情况/客户
 - 6、企业半导体光刻胶业务布局战略&优劣势
- 7.3.10 北京科华微电子材料有限公司
 - 1、企业发展历程&基本信息
 - 2、企业业务架构&经营情况
 - 3、企业半导体光刻胶产品/产线布局
 - 4、企业半导体光刻胶专利技术
 - 5、企业半导体光刻胶产销情况/客户
 - 6、企业半导体光刻胶业务布局战略&优劣势

——展望篇——

第8章：中国半导体光刻胶行业发展环境洞察&SWOT分析

8.1 中国半导体光刻胶行业经济（Economy）环境分析

- 8.1.1 中国宏观经济发展现状
- 8.1.2 中国宏观经济发展展望
- 8.1.3 中国半导体光刻胶行业发展与宏观经济相关性分析

8.2 中国半导体光刻胶行业社会（Society）环境分析

- 8.2.1 中国半导体光刻胶行业社会环境分析
- 8.2.2 社会环境对半导体光刻胶行业发展的影响总结

8.3 中国半导体光刻胶行业政策（Policy）环境分析

- 8.3.1 国家层面半导体光刻胶行业政策规划汇总及解读（指导类/支持类/限制类）
 - 1、国家层面半导体光刻胶行业政策汇总及解读
 - 2、国家层面半导体光刻胶行业规划汇总及解读
- 8.3.2 31省市半导体光刻胶行业政策规划汇总及解读（指导类/支持类/限制类）
 - 1、31省市半导体光刻胶行业政策规划汇总
 - 2、31省市半导体光刻胶行业发展目标解读
- 8.3.3 国家重点规划/政策对半导体光刻胶行业发展的影响
- 8.3.4 政策环境对半导体光刻胶行业发展的影响总结

8.4 中国半导体光刻胶行业SWOT分析（优势/劣势/机会/威胁）

第9章：中国半导体光刻胶行业市场前景及发展趋势分析

- 9.1 中国半导体光刻胶行业发展潜力评估
- 9.2 中国半导体光刻胶行业未来关键增长点分析
- 9.3 中国半导体光刻胶行业发展前景预测（未来5年预测）
- 9.4 中国半导体光刻胶行业发展趋势预判

- 9.4.1 中国半导体光刻胶行业市场竞争趋势
- 9.4.2 中国半导体光刻胶行业技术创新趋势
- 9.4.3 中国半导体光刻胶行业细分市场趋势
 - 1、EUV光刻胶的比重将会提升
 - 2、ArF光刻胶国产替代有望加快

第10章：中国半导体光刻胶行业投资战略规划策略及建议

10.1 中国半导体光刻胶行业进入与退出壁垒

- 10.1.1 半导体光刻胶行业进入壁垒分析
 - 1、技术壁垒（配方技术、质量控制技术和原材料技术）
 - 2、客户认证壁垒
 - 3、设备壁垒
 - 4、原材料壁垒
 - 5、资金壁垒
 - 6、资质壁垒
- 10.1.2 半导体光刻胶行业退出壁垒分析

10.2 中国半导体光刻胶行业投资风险预警

10.3 中国半导体光刻胶行业投资机会分析

- 10.3.1 半导体光刻胶产业链薄弱环节投资机会
- 10.3.2 半导体光刻胶行业细分领域投资机会

- 10.3.3 半导体光刻胶行业区域市场投资机会
- 10.3.4 半导体光刻胶产业空白点投资机会
- 10.4 中国半导体光刻胶行业投资价值评估
- 10.5 中国半导体光刻胶行业投资策略与建议

图表目录

- 图表1: 光刻胶的定义
- 图表2: 一种NMOS三极管集成电路结构的制造过程
- 图表3: 半导体光刻胶涂抹方法
- 图表4: 光刻胶主要技术参数
- 图表5: 本报告研究领域所处行业
- 图表6: 光刻胶行业所属的国民经济分类
- 图表7: 光刻胶专业术语
- 图表8: 光刻胶概念辨析
- 图表9: 光刻胶按下游应用分类
- 图表10: 半导体光刻胶产品分类及特征
- 图表11: 半导体光刻胶行业分类
- 图表12: 本报告研究范围界定
- 图表13: 光刻胶行业监管体系及机构介绍
- 图表14: GB/T 16527-2024年(硬面感光板中光致抗蚀剂和电子束抗蚀剂)基本内容
- 图表15: 晶瑞电材光刻胶企业标准汇总
- 图表16: Q/320506 ZRH47-2020(I线正性光刻胶)部分产品标准内容
- 图表17: 本报告权威数据资料来源汇总
- 图表18: 本报告的主要研究方法及统计标准说明
- 图表19: 全球光刻胶行业在萌芽期的重要事件
- 图表20: 全球光刻胶行业在初步发展期的重要事件
- 图表21: 全球光刻胶行业在快速发展期的重要事件
- 图表22: 全球半导体光刻胶技术进展情况
- 图表23: 全球半导体光刻胶厂商产品研发进度情况
- 图表24: 全球半导体光刻胶工厂分布情况
- 图表25: 全球半导体光刻胶行业主要企业生产进度
- 图表26: 全球半导体光刻胶行业细分产品应用占比(单位: %)
- 图表27: 全球光刻胶应用结构(单位: %)
- 图表28: 全球光刻胶行业主要兼并、重组事件
- 图表29: 全球光刻胶行业的竞争梯队(按市场份额)
- 图表30: 全球光刻胶行业市场份额(单位: %)
- 图表31: 全球半导体光刻胶行业细分市场格局(单位: %)
- 图表32: 全球光刻胶行业市场集中度(单位: %)
- 图表33: 全球各地区半导体产能份额占比
- 图表34: 全球半导体光刻胶行业重点区域市场分析
- 图表35: 全球半导体光刻胶行业市场规模体量分析
- 图表36: 全球光刻胶行业市场规模情况(单位: 亿美元)
- 图表37: 全球半导体光刻胶行业市场前景预测(未来5年预测)
- 图表38: 全球半导体光刻胶行业发展趋势洞悉
- 图表39: 全球半导体光刻胶行业发展经验总结和有益借鉴
- 图表40: 日本光刻胶产业崛起因素简析
- 图表41: 中国半导体光刻胶行业发展历程
- 图表42: 半导体光刻胶行业科研投入状况(研发力度及强度)
- 图表43: 半导体光刻胶行业科研投入(力度及强度)
- 图表44: 半导体光刻胶行业科研创新(专利与转化)
- 图表45: 半导体光刻胶行业关键技术(现状与发展)
- 图表46: 半导体光刻胶生产工艺流程
- 图表47: 半导体光刻胶行业市场主体类型
- 图表48: 半导体光刻胶行业企业入场方式
- 图表49: 半导体光刻胶行业市场主体数量

- 图表50: 半导体光刻胶注册/在业/存续企业
- 图表51: 中国光刻胶生产企业类型结构 (单位: %)
- 图表52: 中国半导体光刻胶行业市场供给分析
- 图表53: 中国各类光刻胶产品生产企业分布情况
- 图表54: 中国光刻胶行业市场供给分析
- 图表55: 中国光刻胶产量及测算 (单位: 吨)
- 图表56: 中国部分光刻材料项目建设进展情况
- 图表57: 中国半导体光刻胶行业市场需求分析
- 图表58: 中国半导体光刻胶自给率情况 (单位: %)
- 图表59: 中国光刻胶行业市场规模体量分析
- 图表60: 中国光刻胶市场规模体量 (单位: 亿元)
- 图表61: 中国半导体光刻胶市场规模 (单位: 亿美元)
- 图表62: 中国半导体光刻胶行业市场规模体量分析
- 图表63: 中国半导体光刻胶行业企业竞争格局分析
- 图表64: 中国半导体光刻胶竞争格局 (单位: %)
- 图表65: 中国半导体光刻胶行业市场集中度分析
- 图表66: 中国光刻胶国产替代现状
- 图表67: 中国半导体光刻胶行业市场发展痛点分析
- 图表68: 半导体光刻胶产业链结构梳理
- 图表69: 光刻胶行业产业链示意图
- 图表70: 半导体光刻胶产业链区域热力图
- 图表71: 光刻胶基本成分介绍
- 图表72: 光刻胶原材料用量及成本占比
- 图表73: 光刻胶行业价值链分析图
- 图表74: 光刻胶单体及树脂市场发展现状
- 图表75: 应用于光刻胶的树脂中国市场供应商情况
- 图表76: 中国光刻胶树脂供应商产能产量情况 (单位: 吨/年, 万吨, %)
- 图表77: PCB光刻胶-树脂市场均价参考 (单位: 元/千克, %)
- 图表78: 光刻胶原材料: 光敏材料市场发展现状
- 图表79: 光引发剂分类
- 图表80: 2014-2024年中国光引发剂产量 (单位: 万吨)
- 图表81: 中国光引发剂供应商情况
- 图表82: 中国光刻胶光引发剂供应商产能情况 (单位: 吨/年, 万吨/年, %)
- 图表83: 容大感光光刻胶-光引发剂采购均价参考 (单位: 元/千克, %)
- 图表84: 久日新材光刻胶-光引发剂销售均价参考 (单位: 元/千克, %)
- 图表85: PMA下游消费结构 (单位: %)
- 图表86: PMA产能区域分布情况 (单位: %)
- 图表87: 中国PMA行业竞争情况 (按产能) (单位: 万吨/年)
- 图表88: 容大感光光刻胶-溶剂采购均价参考 (单位: 元/千克, %)
- 图表89: 原材料供应对半导体光刻胶行业的影响
- 图表90: 中国半导体光刻胶行业细分市场结构
- 图表91: 中国半导体光刻胶市场结构 (单位: %)
- 图表92: 中国G线光刻胶市场简析
- 图表93: 中国I线光刻胶市场简析
- 图表94: 中国KrF光刻胶市场简析
- 图表95: 中国ArF光刻胶市场简析
- 图表96: 中国半导体光刻胶行业细分市场战略地位分析
- 图表97: 全球半导体产业迁移路径图及迁移结构
- 图表98: 中国半导体产业销售额及其增长情况 (单位: 亿美元, %)
- 图表99: 中国集成电路市场规模 (单位: 亿元, %)
- 图表100: 中国集成电路市场结构 (单位: %)
- 图表101: 2025-2030年中国半导体行业销售额预测 (单位: 亿美元)
- 图表102: 中国半导体产业发展趋势
- 图表103: 逻辑IC领域半导体光刻胶应用概述
- 图表104: 逻辑IC市场现状
- 图表105: 逻辑IC发展趋势
- 图表106: 逻辑IC领域半导体光刻胶应用市场现状
- 图表107: 逻辑IC领域半导体光刻胶应用市场潜力
- 图表108: 动态随机存取存储器 (DRAM) 领域半导体光刻胶应用概述

图表109: 动态随机存取存储器 (DRAM) 市场现状
图表110: 动态随机存取存储器 (DRAM) 发展趋势
图表111: 动态随机存取存储器 (DRAM) 领域半导体光刻胶应用市场现状
图表112: 动态随机存取存储器 (DRAM) 领域半导体光刻胶应用市场潜力
图表113: NVM (非易失性内存) 领域半导体光刻胶应用概述
图表114: NVM (非易失性内存) 市场现状
图表115: NVM (非易失性内存) 发展趋势
图表116: NVM (非易失性内存) 领域半导体光刻胶应用市场现状
图表117: NVM (非易失性内存) 领域半导体光刻胶应用市场潜力
图表118: 半导体光刻胶行业细分应用波士顿矩阵分析
图表119: 全球及中国半导体光刻胶主要企业布局梳理
图表120: 华懋 (厦门) 新材料科技股份有限公司发展历程
略 完整目录请咨询客服

如需了解报告详细内容, 请直接致电前瞻客服中心。

全国免费服务热线: 400-068-7188 0755-82925195 82925295 83586158

或发电子邮件: service@qianzhan.com

或登录网站: <https://bg.qianzhan.com/>

我们会竭诚为您服务!